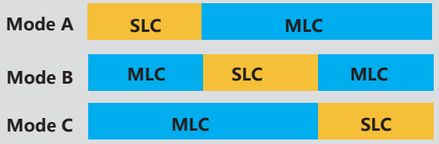
FORESEE® fSD

SLC+MLC架构模式



FORESEE fSD框架图

容　量	4GB/8GB/16GB
接　口	SD 2.0, 向下兼容SD1.1, SD1.0
架　构	嵌入式级别MLC FLASH+控制器
先进功能	与eMMC封装管脚完全兼容 / SLC + MLC 分区灵活分割模式 / 全局擦写平衡
定制功能	只读区域/防拷贝/隐藏区
温度范围	芯片存储温度: -45~85℃,芯片运行温度: -25~85 ℃
擦写寿命	超过5000次（Ta=25°C@3.3V）
封装尺寸	11.5mmx13mmx1.1mm, 153-ball FBGA 12mmx16mmx1.2mm, FBGA169
产品状态	已量产

fSD与eMMC 区别

相 同　相同FBGA封装，相同芯片尺寸;
相同管脚定义。

目标市场：使用eMMC 有成本压力的客户

不 同　eMMC协议是eMMC 4.41,而fSD协议是SD2.0，江波龙已在平台端做认证，
帮助客户完成开发；fSD 可以直接在PCB上取代eMMC，从而实现更低成本。